

制御技術とコンピュータ そして組み込み

Ei2 ハードウェア技術

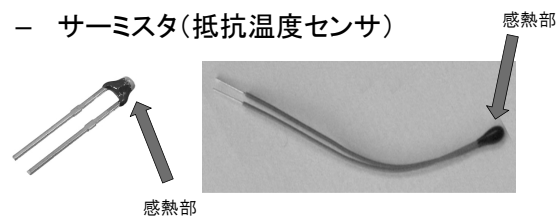
1

• 再び水温制御 温度センサ……検出部

設定温度以上未満でスイッチング (ON-OFF)

• 温感素子

- サーマスタ(抵抗温度センサ)



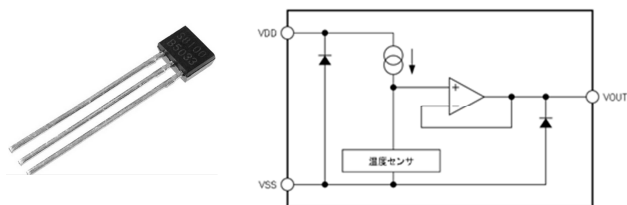
2

• 再び水温制御 温度センサ……検出部

設定温度以上未満でスイッチング (ON-OFF)

• 温感素子

- 半導体温度センサ(IC型・ダイオード)



3

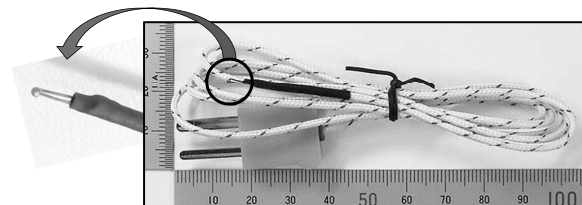
• 再び水温制御 温度センサ……検出部

設定温度以上未満でスイッチング (ON-OFF)

• 温感素子

- 熱電対(センサ)温度計

2種金属の接合点において起電力が生じる現象
(ゼーベック効果)を利用

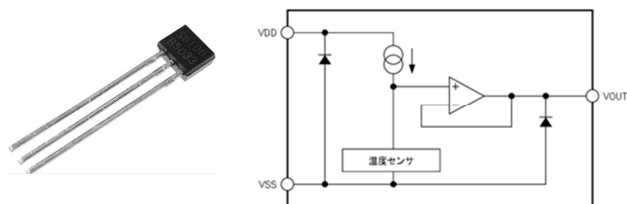


• 再び水温制御 温度センサ……検出部

設定温度以上未満でスイッチング (ON-OFF)

• 温感素子

- 半導体温度センサ(IC型・ダイオード)



5

• 温度センサ サーマスタ素子(PCB実装型)



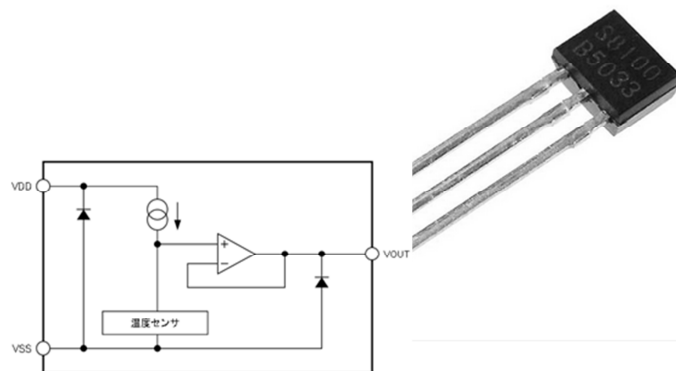
6

• 温度センサ サーミスタ（自動車用）



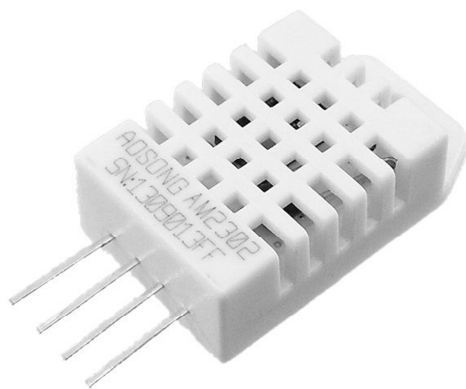
7

• 温度センサ IC温度センサ（PCB実装型）



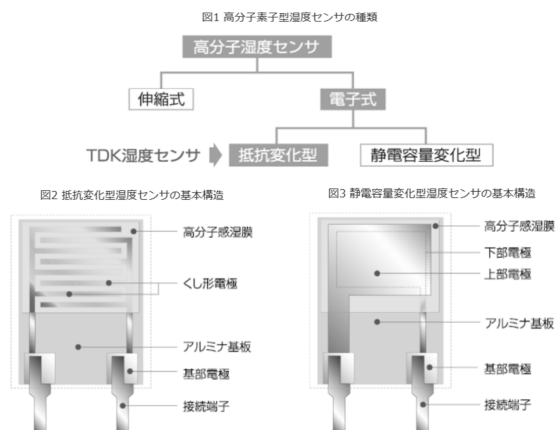
8

• 温湿度センサ センサーモジュール



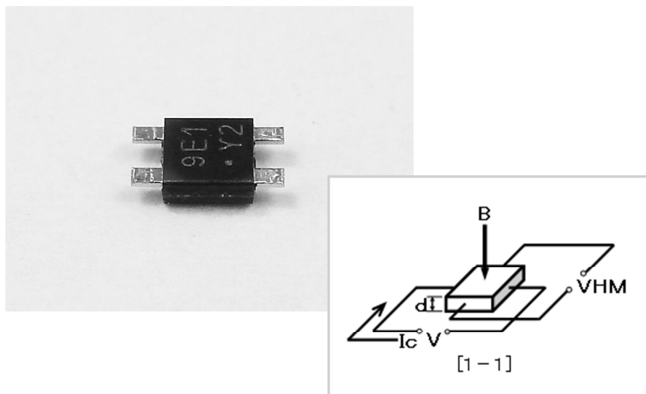
9

• 温湿度センサ センサーモジュール



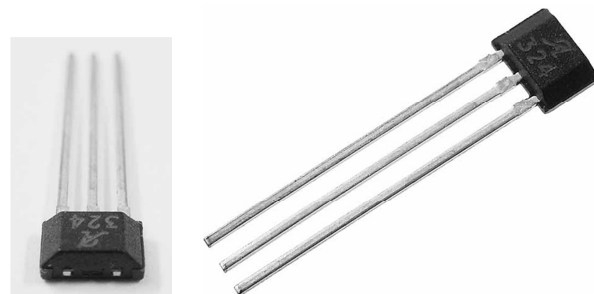
10

• 磁気センサ ホール素子



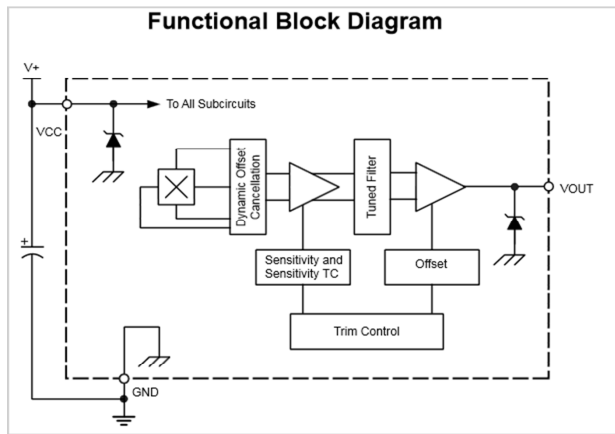
11

• 磁気センサ ホール素子



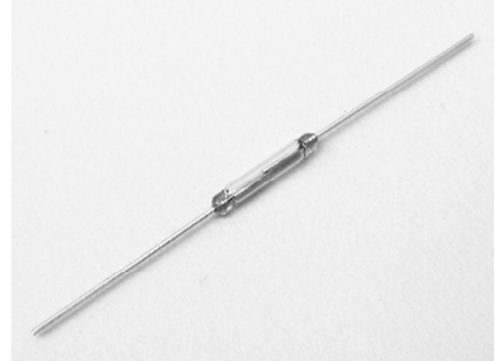
12

・磁気センサ ホール素子



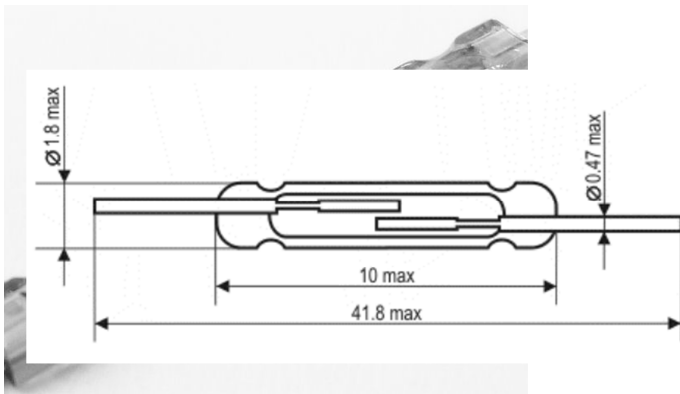
13

・磁気センサ リードスイッチ



14

・磁気センサ リードスイッチ



15

組込みハードウェアの LSI 化

組込みハードウェアを小型化するためには、回路を LSI 化することが有効である。近年では、半導体技術の進歩によって大規模な回路であっても、比較的容易に LSI 化することが可能になった。ここでは、組込みハードウェアに使われる LSI について学習する。

システム LSI

ハードウェアとして必要な主要機能を 1 個の LSI チップに内蔵することを、SoC といい、このような LSI をシステム LSI という。

図 6-18 に、システム LSI のおもな種類を示す。システム LSI は、ASIC や PLA を用いて実現することができる。また、音声や画像処理を専用に行う LSI である DSP やシングルチップ形マイコンもシステム LSI の 1 種である。



図 6-18 システム LSI のおもな種類

16

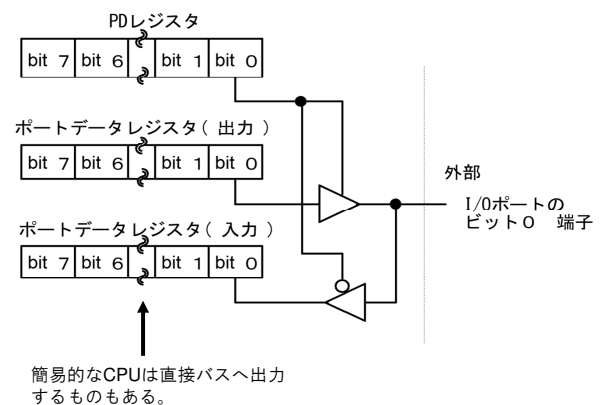
・センサのまとめ

何で何を測定するの？

- ・ジャイロセンサー (星測位システム関連 (GPS モジュール))
- ・加速度センサー (温度センサー) (湿度センサー)
- ・光センサー (フォトダイオード) (UV センサ (紫外線センサ)) (フォトリフレクタ (反射型光センサ)) (フォトンタラ (透過型光センサ))
- ・放射線センサ (シンチレータ) GM 管 (ガイガー管)
- ・音センサ (音声帯域 (マイク)) 超音波センサ (pH (酸/アルカリ (塩基) センサ))
- ・アルコール・ガス センサ
- ・距離センサー (動体センサー (ドップラーレーダー センサ))
- ・角度センサー (磁気センサー/ホール素子) リードスイッチ
- ・圧力・加圧・感圧・大気圧センサ 荷重変換器 (ロードセル Loadcell)
- ・ジョイスティック (チルトスイッチ) (電流センサ)

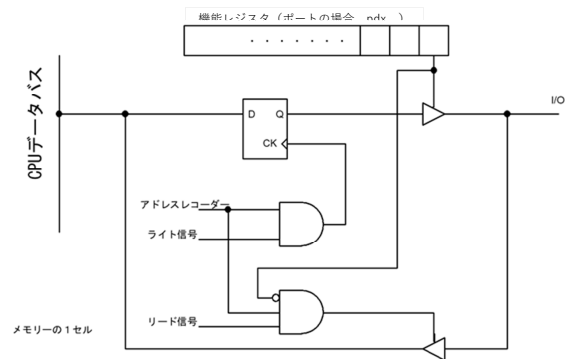
17

I/Oポートの設定



18

I/Oポートの仕組み もうちょっと詳しく R8Cの実際



I/O関係だけ抜粋 19

マイコンの初期化 I/Oの準備

```
// ポートの入出力設定
p0  = 0x00;
prc2 = 1;           // PD0のプロテクト解除
pd0  = 0x70;        // Sin p0_7
pur0 |= 0x04;       // P1_3~P1_0のプルアップON
p1   = 0x00;
pd1  = 0x10;
```

p1 や pd1は変数のようにアクセスできますが変数とはちょっと違います。変数の実アドレスはリンカーが決定。p1 pd1はLSI設計時にアドレスが決められます。

アドレス情報をコンパイラに伝える

```
#pragma ADDRESS #pragma ADDRESS p0_addr 00E0H // Port P0 Register
#pragma ADDRESS pd0_addr 00E2H //P0 Direction Register
• この後
#define p0 p0_addr.byte
#define pd0 pd0_addr.byte
というようにdefineしています。

#pragma
機種依存のいろいろな設定を行う命令なので、
この命令の働きはコンパイラによって異なります
```

アドレス情報をコンパイラに伝える #pragma ADDRESS

```
#define宣言で 割り当ててみる？
#define p0_addr 00E0H
・・・ではだめ！！ 理由を考えよう
```

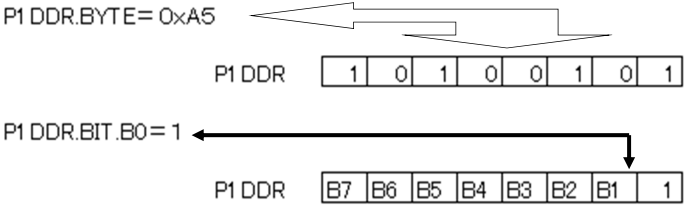
unsigned char p0_addr; //変数として宣言
変数宣言ではアドレスがどこに振られるかわかりません。
(ちなみにビルドでエラーは出ません)

(2)ビットフィールドを読み取る場合

```
Union pd1 {
    unsigned char BYTE; /* union pd1 */
    struct { /* Byte Access */
        unsigned char B7:1; /* Bit Access */
        unsigned char B6:1; /* Bit 7 */
        unsigned char B5:1; /* Bit 6 */
        unsigned char B4:1; /* Bit 5 */
        unsigned char B3:1; /* Bit 4 */
        unsigned char B2:1; /* Bit 3 */
        unsigned char B1:1; /* Bit 2 */
        unsigned char B0:1; /* Bit 1 */
    } BIT; /* Bit 0 */
};

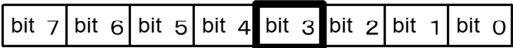
8 ビットアクセス pd1.BYTE
1 ビットアクセス pd1.BIT.B0
```

8 ビットアクセス P1DDR.BYTE
1 ビットアクセス P1DDR.BIT.B0
UNION メモリーを共有する (共用体)



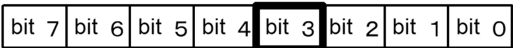
p1の3 bitをp2の3ビットへ転送する

ポートデータレジスタ (p1)



bit3のみコピーする

ポートデータレジスタ (p2)



bit3以外は値が変わらない

25

ビットフィールド構造体を利用すると

p1の3 bitをp2の3ビットへ転送する例、同じ実行結果になるプログラムです

```
315 ## # C_SRC :      p2_3 = p1_3;

316 0001E 7EBF0B07      btst 3,_p1_addr
317 00022 7E2F2307FA      bmnz    3,_p2_addr
```

```
315 ;## # C_SRC :      p2=( p2 & 0xf7 ) | ( p1 & 0x08);

316 0001E 33E400      S  mov.b  _p2_addr,A0
317 00021 7724F700      and.w  #00f7H,A0
318 00025 0BE100      S  mov.b  _p1_addr,R0L
319 00028 B3          Z  mov.b  #00H,R0H
320 00029 77200800      and.w  #0008H,R0
321 0002D 9904          or.w R0,A0
322 0002F 724FE400      mov.b  A0,_p2_addr
```

コード効率が良くなるー実行速度が速い

ビットフィールドの長所と短所

- 長所
 - ープログラムがわかりやすい (マスク処理省略)
 - ーコード効率が良い (実行が速い)
- 短所
 - ー機種依存性があり、プログラムの移植性が悪い
 - ー実変数名が長くなる
 - ーヘッダファイル (構造体宣言) が必要

機能モジュールが膨大になり大変な量となる

以前はプログラマーが必要な機能だけ宣言していたが、利便性の向上のためメーカーが準備するようになった。
“ヘッダファイルのないCPUは売れなくなった”